

글로벌 No.1 소재 · 부품 기업



History



1970-1998

창업·기반구축

- 1970 / 회사 설립
- 1971 / 국내 최초 TV 튜너 생산
- 1984 / 색도 마스크 생산
- 1990 / 포토 마스크 생산
- 1997 / 반도체 기판 생산



1999-2008

성장·발전

- 2000 / LED, 테이프 서브스트레이트 사업 전개
- 2001 / 파워모듈 사업 전개
- 2002 / 디지털 튜너 글로벌 M/S 1위
- 2003 / 카메라 모듈 사업 전개
- 2007 / 차량부품 사업 전개



2009-2020

시장 선도

- 2009 / 테이프 서브스트레이트 글로벌 M/S 1위
- 2011 / 카메라모듈 글로벌 M/S 1위
- 2012 / 포토마스크 글로벌 M/S 1위
- 2013 / 세계 최초 6인치 웨이퍼 UV LED 양산
- 2014 / 차량용 통신모듈 글로벌 M/S 1위
- 2016 / 듀얼 카메라 글로벌 시장 선점
- 2017 / 세계 최초 100mW UV-C LED 개발
 - 세계 최초 글라스렌즈 적용 듀얼 카메라모듈 개발
 - 세계 최초 2세대 V2X 풀모듈 개발
- 2018 / 어드밴스트 플립칩 LED 패키지 개발
 - 차량용 'C-V2X 모듈' 개발
- 2019 / 3D 센싱부품 'ToF 모듈' 본격 양산
 - 차량용 플렉시블 입체조명 '넥슬라이드-HD' 개발
 - 세계 최초 5G 퀄컴칩기반 '차량용 통신모듈' 개발
- 2020 / 세계 최소형 IoT용 'BLE모듈' 개발
 - 고효율 자성소재 개발
- 2021 / 차량용 '디지털 키 모듈' 개발
 - 세계 최초 '차량용 와이파이6E 모듈' 개발

Organization



Vision



Global Network

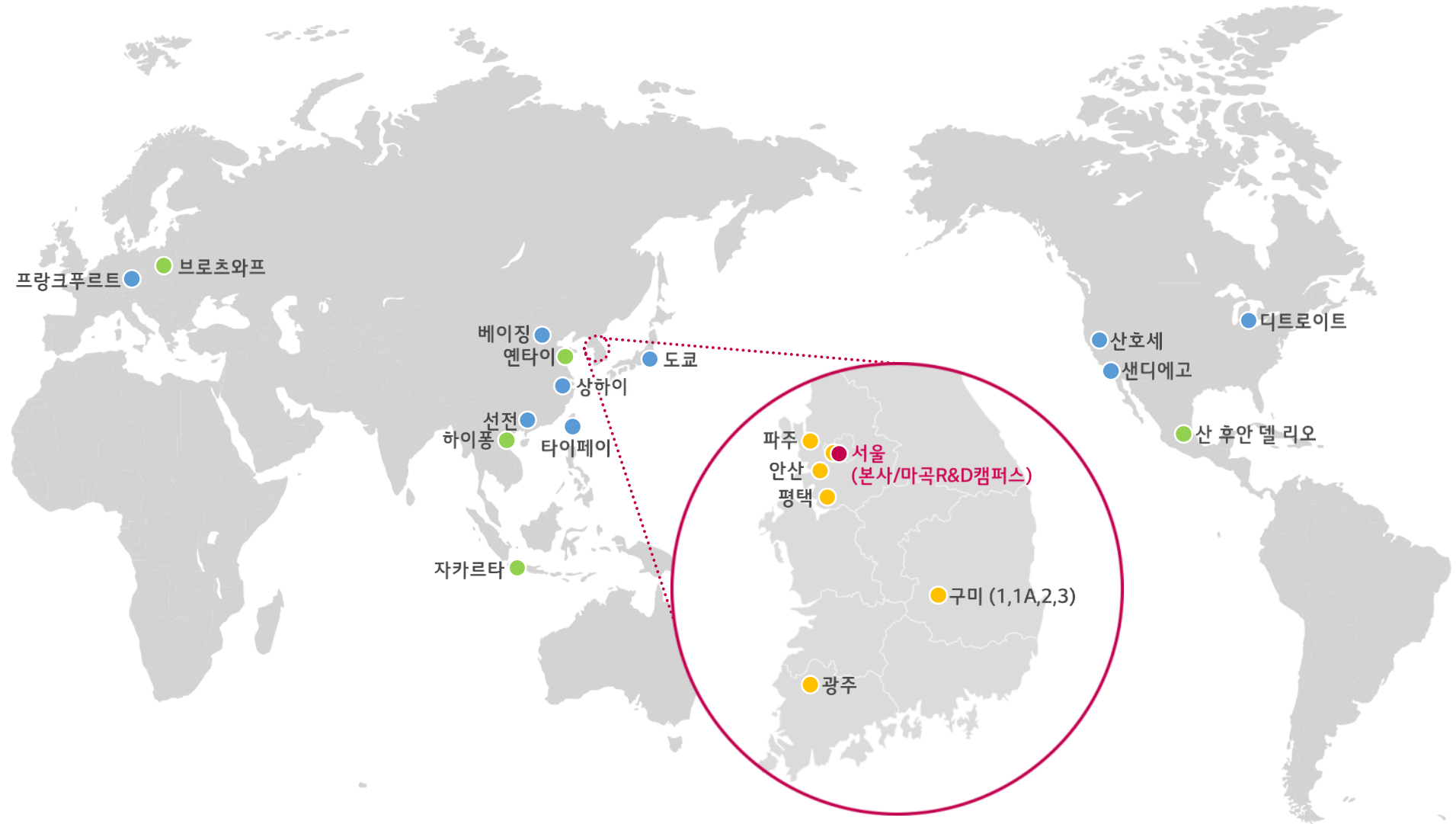
KOREA

- 1 본사
- 6 사업장

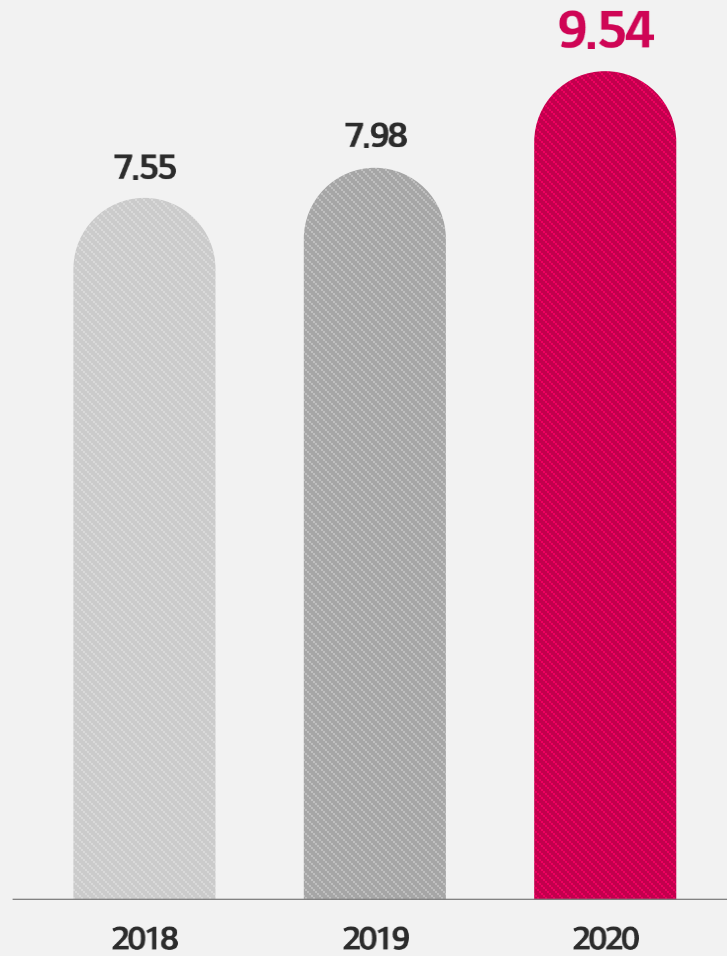
Overseas

- 5 생산법인
- 9 판매법인/지사/사무소

- 본사
- 사업장
- 생산법인
- 판매법인 / 지사 / 사무소

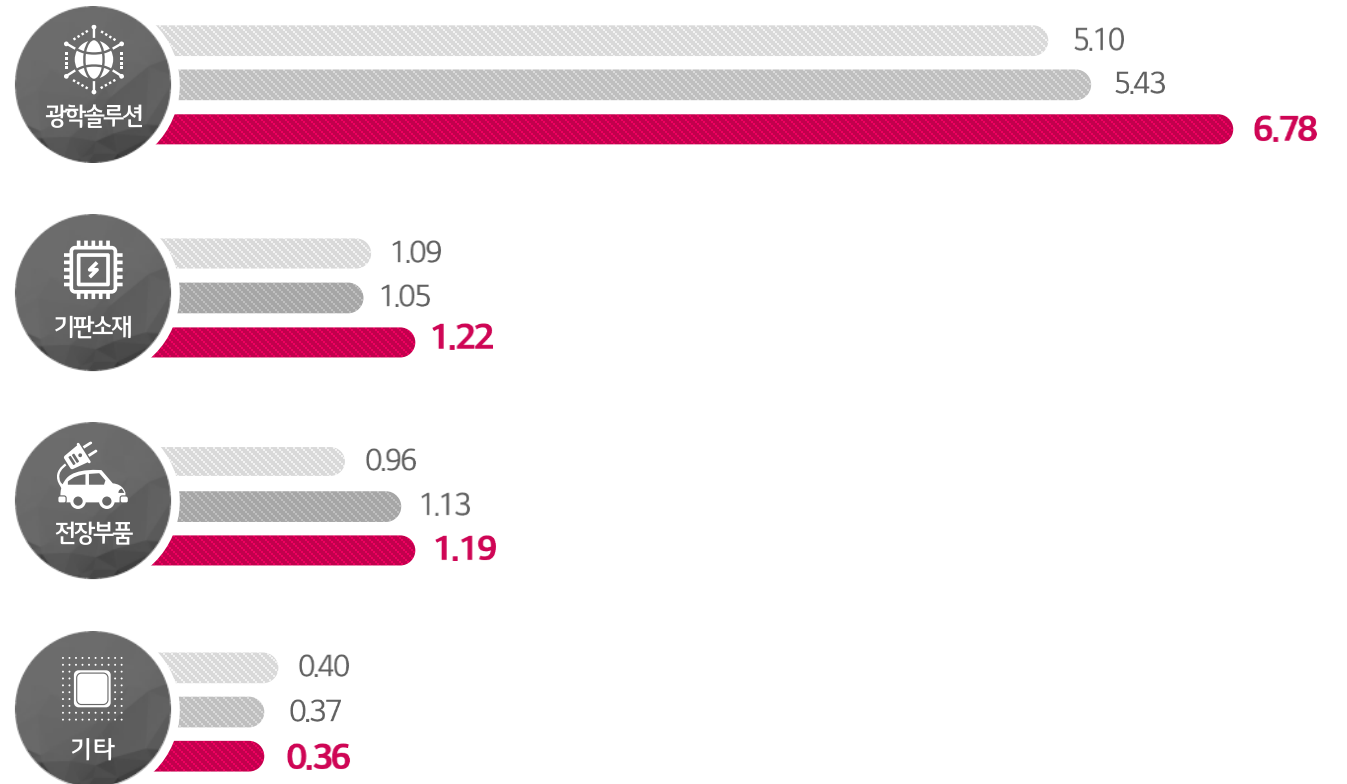


Business Performance

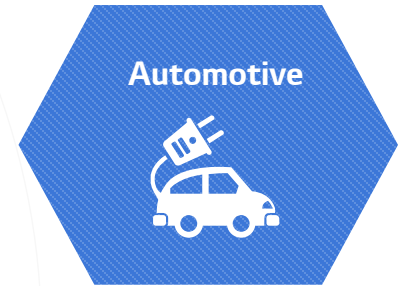
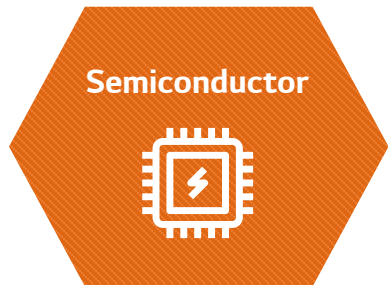
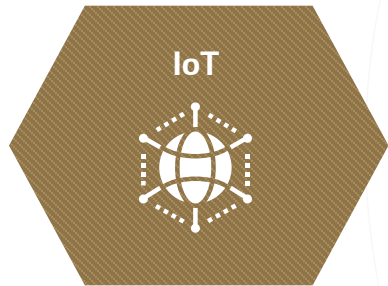


사업부별 매출 실적

○ 2018 ○ 2019 ● 2020 (단위:조원)



Business Area



Mobile Components



Mobile



3D Sensing Module



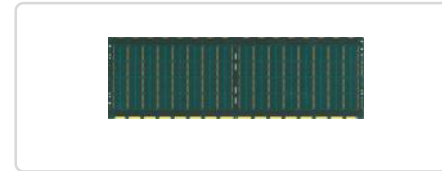
Camera Module



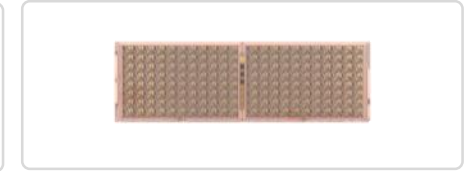
Flip Chip CSP (ETS-TCFC)



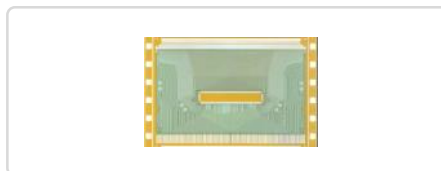
CSP (Ultra Thin)



SiP



COF



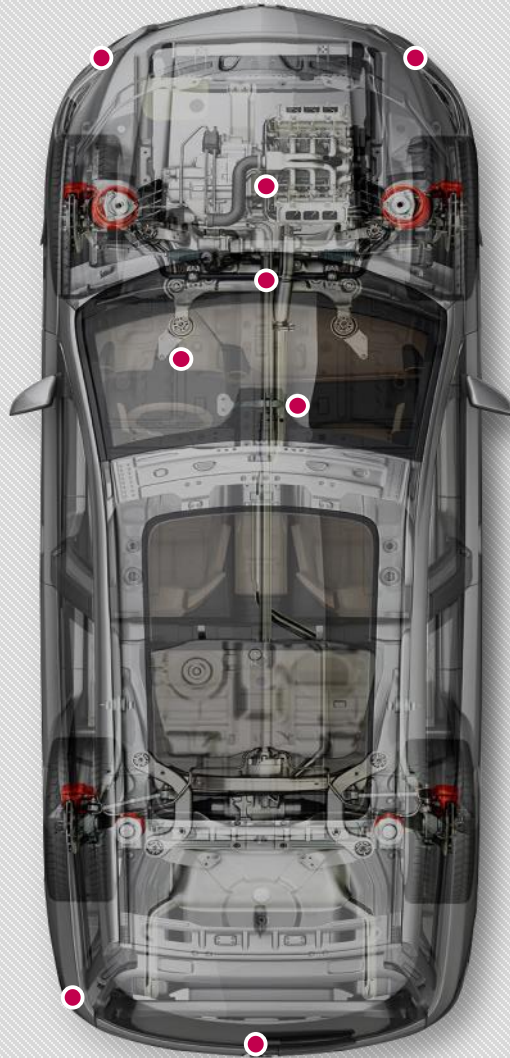
2 Metal COF



Automotive Components



Automotive



Actuator & Sensor Solution

- ❑ Motor for Electric power steering (EPS)
- ❑ Motor for Braking system (ABS/ESC/AEB)
- ❑ Gear Integrated Module for FBS
- ❑ Motor for Dual clutch transmission (DCT)
- ❑ Electric Oil Pump
- ❑ Sensor for Steering system (TAS/TOS/TIS)



Connectivity & Camera Solution

- ❑ Cellular Module (LTE/5G)
- ❑ Bluetooth / Wi-Fi module
- ❑ V2X module
- ❑ Radar
- ❑ Camera module



xEV Solution

- ❑ Battery Management System
- ❑ DC-DC Converter
- ❑ Electric Vehicle Communication Controller



Lighting Solution

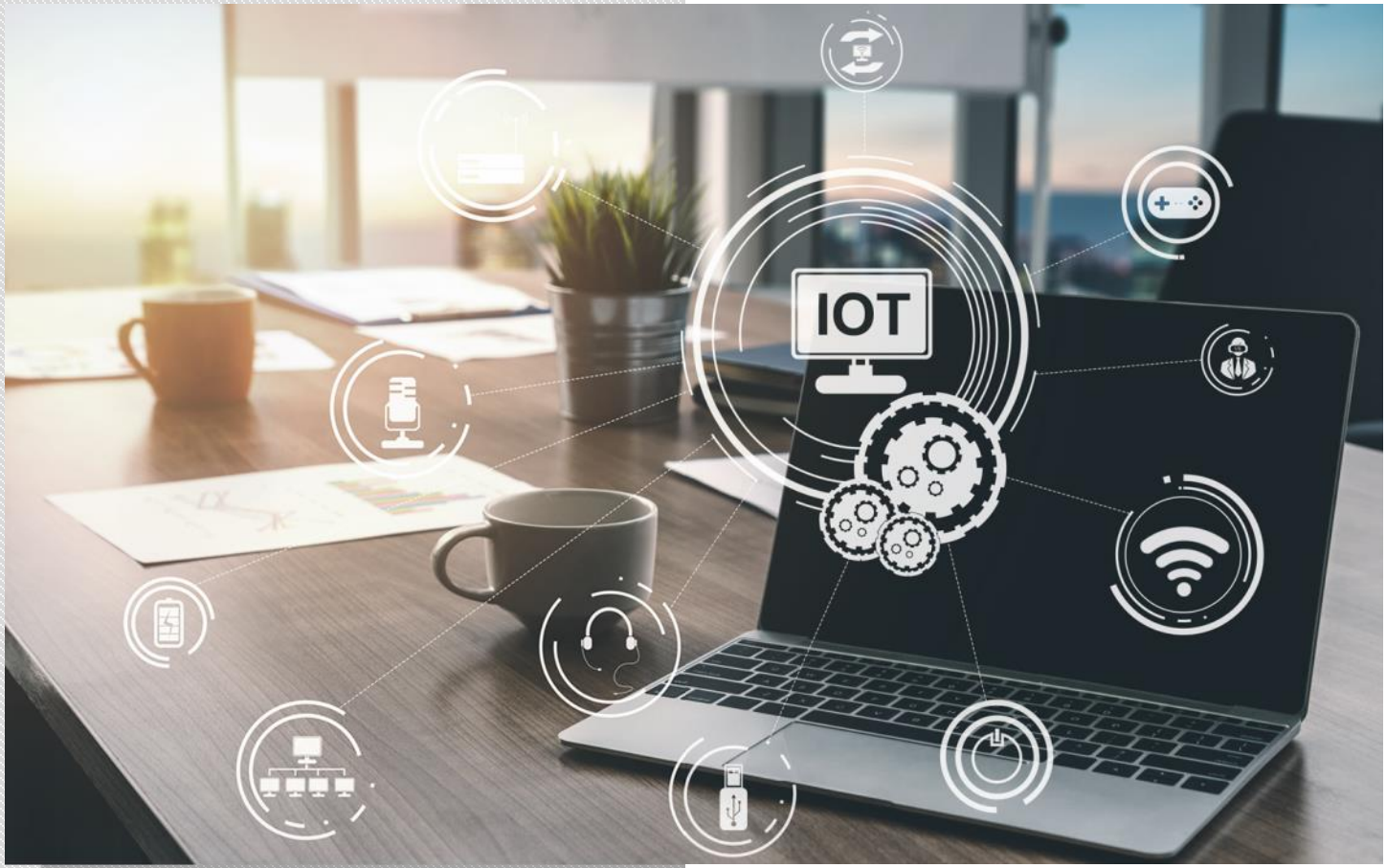
- ❑ LED Module for Automotive
- ❑ LED Driver Module for Automotive



IoT Components



IoT



Wi-Fi Module



BLE SiP



Smart Camera for IoT



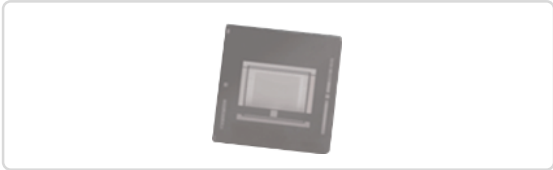
Display Components



Display



Photo Mask



Power Module



Digital Tuner

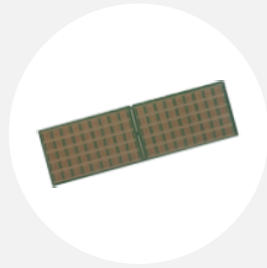


Semiconductor Components



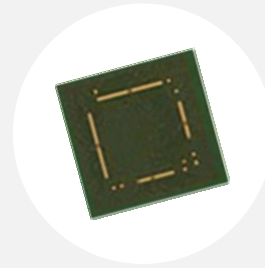
01 Flip Chip CSP (ETS-TCFC)

- ❑ Mobile phone
- ❑ Portable device



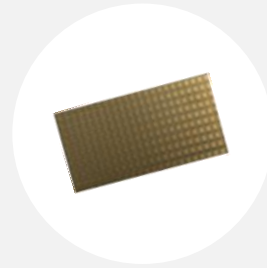
02 CSP (Ultra Thin)

- ❑ Mobile phone
- ❑ Portable device



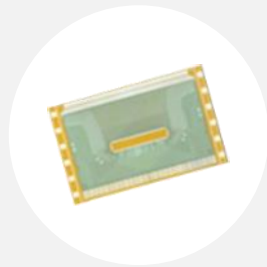
03 SiP

- ❑ Mobile phone
- ❑ Portable device



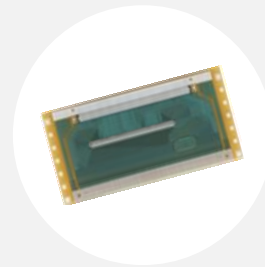
04 COF

- ❑ Mobile phone
- ❑ Portable device
- ❑ Display



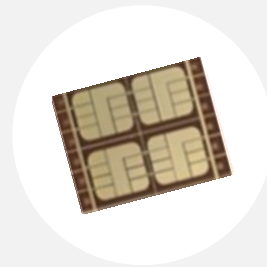
05 2 Metal COF

- ❑ Mobile phone
- ❑ Portable device



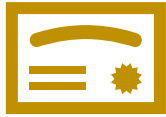
06 COB (Smart IC)

- ❑ Banking/Credit card
- ❑ USIM card
- ❑ ID card
- ❑ Transportation card



Semiconductor

완벽 품질



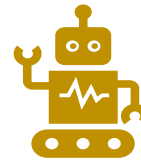
글로벌 품질표준

ISO 9001
IATF16949
ISO 26262



품질 혁신

고객가치 제공을 위한
품질 혁신



품질 관리

선형 품질관리 시스템
Big Data / AI 기반 품질관리

RIGHT PROMISE BETTER TOMORROW

고객



차별화된
가치 제공

임직원



자부심/자긍심은
느끼는 일터조성

협력사



지속가능한
Partnership 구축

지역사회



사회공헌은 동한
공존

주주



지속적인
가치 창출

Customer Value Creation

고객 맞춤형 가치 제공 + 장기적 파트너십 구축



기본가치

QCD를 통한
고객 신뢰 확보



경쟁가치

차별화된
경쟁우위 제공



미래가치

선(先)제안을 통한
미래사업 실현

AUTOMOTIVE

DISPLAY

인류가 꿈꾸는 편리하고, 안전하며 즐거운 미래!
LG이노텍의 혁신기술이 함께 합니다.

